

## ウシオ電機株式会社 2026 年（令和 8 年）3 月期 決算説明会

### 主な質問と回答

日時：2026 年 5 月 14 日（木）18:30～19:30

方式：オンライン

説明者：代表取締役社長 兼執行役員社長 CEO 朝日 崇文

＜ご留意事項＞「主な質問と回答」は、決算説明会に出席されなかった方々のために、参考として掲載しています。掲載する内容は、当社の判断で簡潔にまとめたものであることをご了承ください。また、本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があることをご了承ください。

#### ◆ 質問者：ジェフリーズ証券 中名生様

**Q：ステッパ露光装置は、足元でパッケージ基板向け案件の引き合いが増えてきており、2027 年度から本格的に売上に寄与していくとのことですが、2027 年以降も含めどの程度の回復と拡大が見込めるか、そのイメージはありますか。**

A：生産リードタイム等の関係から、今年度(2026 年度)中に見込む引き合いが本格的に立ち上がり、売上として寄与するのは 2027 年度からになります。足元の引き合い状況から、2027 年度から 2028 年度の 2 年間はかなり確度が高い状況です。その後に向けても様々な要望が来ており、2028 年度以降も一定の需要が続くと思いますが、露光装置のスペックを上げていく必要もあり、ステッパ露光装置も含め次世代機への投資を 2028 年度以降に向け拡大し対応していきます。

**Q：パッケージ基板向け露光装置の売上は、過去で言うと 2022 年度頃がかなり高かったと思いますが、その水準まで戻るイメージでしょうか。**

A：今回、そのポテンシャルはあると思っています。パッケージ基板の微細化が進むなか、従来から更にプラスアルファとなるスペック要求も出てきています。私たちの感触では、パッケージサブストレート基板の需要が一部 RDL 層のニーズを取り込みながら拡大しています。マーケットが拡大しているため、ステッパ露光装置のニーズも順調に拡大すると見ていますが、インターポーザー基板層との切り分けが難しい部分があり、かつダイレクトイメージング（DI）露光装置のニーズもあるため、注視していくことが必要と認識しています。

**Q：今後パッケージ基板が微細化し、パッケージサイズの大型化が進むと、市場における DI 方式の比率が高くなるという見方がありますが、ステッパ方式も十分に回復してきており、かつ貴社の場合は両方のソリューションがあるとの点は、優位に働きそうですでしょうか。**

A：パッケージ基板の大型化で DI 露光装置が使われる部分が多くなっていくことはあると思いますが、ステッパ露光装置の安定的な生産性を重視するお客様も多いため、一定の需要を取り込むことはできると考えています。今後のサブストレート基板のサイズ次第ですが、そのなかで DI 方式とステッパ方式の棲み分けができてくるのではと思います。

**Q：従前のサブストレート基板周辺では、貴社のステッパ露光装置はかなり高い市場占有率を有していましたが、2027年以降の市場回復でも、貴社は高いプレゼンスを確保できる見込みでしょうか。**

A：DI方式の採用が進むところも一部あると思いますが、サブストレート基板全体の需要が拡大していますので、そのなかで当社のステッパ露光装置は一定のプレゼンスを確保できると考えています。

**Q：今年度で新成長戦略 Phase I は終了し、目標の ROE 8%以上の達成は時期が後ろ倒しとはいえ、具体的にやろうとしていたことはかなり結実してきていると思います。Phase II は、基本的に以前に示した内容から方向性は大きく変わらないと思いますが、Phase II の発表タイミングや目指す方向性など、現時点で考えていることを教えてくださいいただけますでしょうか。**

A：Phase II の方向性自体は大きく変わりません。Phase II での成長に向けて様々な手を打ってきており、Industrial Process 事業を中心に成長していく方向性にも変わりなく、生成 AI 半導体関連の技術的な要求や分野が広がるなか、今後も開発投資や協業体制の強化といった戦略を立案・推進することで、その成長を牽引していく考えです。パッケージ基板の大型化に対応する露光装置や半導体の生産課題を支える光プロセスなどへの投資が鍵となり、今後、Phase II での成長の大きなポーションを占めていくと考えています。

◆ **質問者：みずほ証券 斉田様**

**Q：露光装置は、足元で引き合い急増という強いコメントがありました。サブストレート基板については、AI 半導体やデータセンターへの投資が動いているなかで、業界全体で日本や韓国、台湾などで投資の話があり、そこでの引き合いが動いているのだと認識していますが、例えば OSAT やコンソーシアム系の開発機構向けに使われる電子部品向けなど、それ以外の分野での貴社の UX-5 や UX-4 に対する引き合い状況はいかがででしょうか。また、ステッパ露光装置、DI 露光装置及び DLT 装置のなかで引き合いが一番活発なのはステッパ露光装置という理解でよいでしょうか。**

A：サブストレート基板向けについては、ご指摘通り日本や韓国、台湾や中国などの主要な基板メーカーとは商談が進んでおり、引き合いが拡大している状況です。UX-5 に関しましては、この分野が中心になっております。UX-4 については、光電融合関連の部品、例えばスイッチング関連でも引き合いが増えてきている状況です。DI 露光装置は、現状は AI 基板、つまりサブストレート基板ではなくメイン基板(プリント基板)の微細化・重厚化が進んでおり、その重厚基板向けで引き合いが強くなってきている状況です。DLT 装置については、案件は多く、2027 年度から需要が本格化してくることは間違いありませんが、インターポーザー基板の大判化の動きと密接に関係しているため、足元では大きく状況が変化していません。従って、足元の引き合いはステッパ露光装置のサブストレート基板向け、DI 露光装置の重厚基板向けが強くなり、今年度(2026 年度)については、DLT 装置よりも、ステッパ露光装置や DI 露光装置が先行して動く見込みです。

**Q：既存のお客様で能力を増強する投資があり、それに伴い貴社の既存装置に対する引き合いが増えているイメージでしょうか。**

A：その通りです。お客様において元々計画していたサブストレート基板の製造ラインの更なる増強や増設の動きに対し引き合いが増えている状況です。

**Q：以前に発表された次世代 UX-5(1.5 $\mu$ m 機)ですが、引き合い状況はいかがででしょうか。また、今年度の DLT 装置の売上計画はどの程度を織り込んでいますでしょうか。**

A：次世代 UX-5(1.5 $\mu$ m 機)ですが、サブストレート基板の引き合いが急増していることもあり、立ち上がり時期は当初計画から変化なく、2028 年以降に貢献開始の方向です。ただし、テクノロジーが複雑化してきているため、次世代機へのシフト要求が高まる可能性もあるとみています。DLT 装置については 2027 年度から本格立ち上がりとみており、今年度はまだ限定的な数量とみています。

**Q：DLT 装置の売上は、前年度(2025 年度)も限定的な台数と認識していますが、今年度も限定的な規模ではありつつも計画に織り込んでいるとの理解でよいでしょうか。**

A：ご理解の通りです。

**Q：OSRAM 事業の買収について、今年度の業績(営業利益)貢献が連結効果でプラス 28 億円、一時費用でマイナス 33 億円とのことですが、次年度(2027 年度)を見据えたときに、一時費用のマイナス 33 億円はのれん償却を除いて全てなくなると思ってよいのでしょうか。**

A：一時費用のなかで大きいのは PMI コストになり、この部分は今年度のみの計上になります。のれん償却はその後も残り、金額は 13 億／年です。

**Q：一時コスト 33 億円のうち、20 億円は次年度に向け解消すると認識しておけばよいでしょうか。**

A：その通りです。

**Q：露光装置の需要が急速に立ち上がってきている状況かと思えます。ステツパ露光装置は以前に生産調整をしていた認識です。足元の中東情勢等に伴う不透明感のなかで、この急な需要立ち上がりに対応するための製造キャパシティ及びサプライヤーからの部材調達の手当はできている状況でしょうか。**

A：今回の需要増加に対する生産体制が確保できるかの点が課題になります。一番の課題は、部材をいかに確保できるかですが、取引先と話をしながら、先行手配等も含めできる限り確保しています。製造キャパシティに関しても、自社生産のみにこだわらず、最も適切に効率的な生産体制を築くべくパートナー含め検討を進めているところです。今後の需要がどの程度増えていくかにもよりますが、お客様との納期調整も行いながら、需要に対応できるように進めている状況です。

**Q：現時点で、納期が延び始めている状況もあるのでしょうか。それとも、現状はまだ希望納期通りに進められている状況でしょうか。**

A：お客様のなかには短納期希望もありますが、適切なタイミングで納入させていただけるよう個別に調整させていただいているところです。

◆ **質問者：モルガン・スタンレーMUFGE証券 田村様**

**Q：ステツパ露光装置で、今回、EMIB-Tに言及していますが、実際に貴社において関連する採用がしツかり進んでいると理解してよいでしょうか。改めてEMIB-Tになると貴社にどういつた事業機会が増えていくのか、また、御社の競争優位性はどのようにでしょうか。**

A：EMIB-T方式での需要は拡大しつつあると見ており、当社のステツパ露光装置が強みを発揮できる分野であると考えています。お客様との関係で、詳細は申し上げられませんが、AI半導体が牽引する需要を支えるテクノロジーの一つとしてEMIB-Tがあり、ここ1～2年のデファクトであった方式にプラスアルファで需要が出始めているので、そのなかで特にサブストレート基板の需要拡大において、ステツパ露光装置のニーズも拡大すると考えています。

**Q：貴社のお客様では2027年ぐらいつに投資を計画されていると思いますので、これに関連した装置は2027年ぐらいつに向けて出荷されると思います。その場合、貴社の売上タイミングや売上規模はどの程度を想定していますでしょうか。**

A：今年度(2026年度)の販売数量は限定的ではありますが、2027～2028年度に向けてステツパ露光装置の出荷が多くなる見込みで、次年度(2027年度)は、今年度よりも大幅に増えていくとみています。次年度の具体的な規模感等については、まだ精査中のため、可能なものから順次報告させていただければと思います。

◆ **質問者：大和証券 福山様**

**Q：貴社の資料をみると、DLT 装置の 2026 年度の数量は限定的であるものの、DLT 装置が 2026 年度の露光装置売上増加の牽引役になるのでしょうか。**

A：2026 年度は、ステップ露光装置の増加も多少ありますが、本格的には 2027 年度からの増加を見込んでいます。従って、DLT 装置の販売台数は多くはないものの、露光装置売上の全体感としては、ご認識のイメージでよいかと思います。

**Q：2027 年度は、貴社の資料を見ると過去の売上ピーク時から 1.2 倍くらいを期待しているように見えますが、いかがでしょうか。**

A：2027 年度については大きく増えると考えていますが、その規模についてはまだ精査中です。

以上